

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2025-010

# 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），未发生变更。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	英唐智控	股票代码	300131
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李昊	闵文蕾	
办公地址	深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 8 层	深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 8 层	
传真	0755-26613854	0755-26613854	
电话	0755-86140392	0755-86140392	
电子信箱	yitao_stock@yitao.com	yitao_stock@yitao.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）主要业务

公司报告期内主营业务为电子元器件分销，芯片设计制造及软件研发销售等业务。

#### 1. 电子元器件分销业务

2024 年全年，得益于消费电子与新能源汽车市场的蓬勃发展，公司分销业务中的占比较大的手机及汽车电子业务，相较于去年同期销售额有所增长，为分销业务板块实现整体销售额的增长提供了有力支持。2024 年度，凭借强大的渠道服务能力和与上下游客户的稳定合作关系，公司分销业务板块实现营业收入为 488,176.54 万元，较上年同期上升 6.58%。

但受电子行业整体供需格局的变化以及市场竞争日益激烈等多重因素影响，各类电子元器件的价格相较于往年同期走低，各产品线毛利有所下降。

## 2. 芯片设计制造业务

### （1）MEMS 微振镜项目

截至报告期末，公司与全资子公司日本英唐微技术联合研发的 MEMS 微振镜， $\phi 4\text{mm}$  规格已成功通过类车规验证， $\phi 8\text{mm}$  规格则已步入客户送样阶段。公司就 MEMS 微振镜项目，已与激光雷达、工业、机器人、无人机、医疗器械、智慧交通等领域客户保持密切沟通，并对多家客户进行送样。

智慧交通、智慧工厂及新能源汽车领域的智能化进程不断加快，对 MEMS 微振镜的应用场景数量与性能指标，提出了更高要求。为覆盖激光雷达、投影显示等应用场景，公司调整开发规划，增加多种规格的 MEMS 微振镜产品研发，以提升技术适配性和场景覆盖能力。2025 年 2 月，经公司董事会审议通过，公司决定将本项目预定可使用状态日期延长至 2026 年 9 月，确保产品精准满足市场需求，提升竞争力。

截至报告披露日， $\phi 4\text{mm}$  规格的 MEMS 微振镜即将步入批量生产阶段，其他规格的 MEMS 微振镜产品开发亦正按计划稳步推进。未来，公司将继续加大对 MEMS 振镜技术的研发与制造投入，致力于进一步拓宽 MEMS 振镜技术的应用场景，携手业界伙伴，共同推动该行业的技术革新与产业升级，以巩固我们的技术领先地位，并持续提升长期经济效益。

### （2）车载显示领域产品

报告期内，公司首款 DDIC 产品、首款 TDDI 产品分别于 2024 年 8 月、12 月实现批量交付。公司拥有的 DDIC、TDDI 两类车载显示芯片，可以支持仪表盘、后视镜显示屏、中控屏、娱乐显示屏等车载显示屏幕，且有较好的触控性能（潮湿状态下仍能精准识别手指位置、可支持 2.5mm 厚手套在 5mm 盖板上的有效触控、还支持旋钮定制方案）。

DDIC 与 TDDI 的后续改进型版本也已步入研发快车道，旨在适应大屏化、多屏化、高清化的车载显示需求和 HUD（抬头显示）等新兴市场需求，强化产品竞争优势。公司将依托国内供应链体系，加速本土化生产布局，提升国产化芯片的设计、生产、运营能力，引领行业发展新篇章。

丰富的上下游渠道资源，稳定的客户合作关系，是公司进入车载显示领域赛道的坚实基础，公司依托以往的渠道经验，与 OEM 厂商及 Tier1（一级供应商）建立了深入且良好的合作关系。目前国内车规级的 DDIC 和 TDDI 市场份额被台湾地区厂商占据大部分，大陆还未出现大批量量产的企业。通过两款产品的批量交付，公司已跻身于该领域推动国产替代的本土厂商前沿。相较于台湾、韩国厂商，公司则更加具备本地化服务优势，可以保证上下游的供应链安全。随着汽车智能化程度的不断提升，车载显示市场加速扩容，车载 DDIC、TDDI 也将会迎来增长，有望为公司开拓新的业绩增长空间。

## 3. 软件研发、销售及维护业务软件研发、销售及维护业务

公司控股子公司优软科技是一家研制 ERP 管理软件、MES 制造执行系统、WMS 智能仓储系统等管理软件的国家高新技术企业，专注服务于电子制造业和电子元器件分销代理行业，拥有多种研发平台，连续多年获得“深圳重合同守信用企业”、深圳软件协会会员单位，同时拥有 30 多项著作权。涵盖了包括财务管理、供应链管理、客户关系管理、人力资源管理、生产制造等企业线上管理的各个方面，致力于实现企业无纸化办公、高效率企业自动化管理及系统层面的企业间信息沟通。

优软科技集资深 IT 专家、行业人员组成的团队打造“以经营管控为核心思想”多账套的 UAS 系统，目前已有过百家集团公司和企业使用该 UAS 系统。优软服务的客户前期主要集中在电子方案设计与制造、元器件分销与代理行业。优软科技的 ERP 与 MES 产品已成功拓展至 MIM 行业市场，取得了初步成效，与行业内多家典型客户签约，并与众多潜在客户建立了初步联系。

在数字化转型浪潮中，企业亟须高效、易用的工具来应对业务挑战。优软科技推出的三大 AI 解决方案，融合了 DeepSeek 的 R1 大模型及基于字节 Coze 平台开发的 AI 能力，以 AI 技术为核心，推出 UAS 智能客服、AI-报表助手、AI-代码助手三大产品，助力企业降本增效，覆盖客服、数据分析和开发协作等关键场景。此外，为满足部分集团化客户在国外工厂的信息化需求，优软在报告期内研发并推出了多语言版本的系统，为后续的业务拓展奠定了坚实基础。

公司将以当前具备的半导体芯片研发、制造能力为基础，继续加大在半导体芯片制造、封装领域的产业布局，并最终形成以电子元器件渠道分销为基础，半导体设计与制造为核心，集研发、制造及销售为一体的全产业链半导体 IDM 企业集团。

## （二）经营模式

### 1. 电子元器件分销业务

#### （1）代理及采购模式

公司根据自身客户资源和行业发展趋势，评估和引入新的产品线；原厂考察并核定公司的代理资格。在代理资格确定以后，销售部门负责新产品线的推广。公司设立了供应链中心，该中心依据销售部门制定的原厂产品采购计划，全面统筹公司采购事务，并负责采购物资的入库管理。

#### （2）销售模式

各事业部依据所选市场或行业，精准定位客户群体，借助市场拓展及原厂资源，直接为下游终端客户提供服务。凭借完善的技术服务团队及仓储物流体系，可为客户提供原厂通用产品的二次开发技术支持、商品采购、物流仓储等全流程的服务。

### 2. 半导体芯片业务

#### （1）采购模式

IDM 模式，综合终端客户/代理商销售预测情况，以及生产管理科生产情况提前备料。业务支援部门负责公司采购事宜，在选择供应商时，综合考虑质量、价格、交货时间、环境和稳定性，除此之外还根据管理条件、社会性和环保工作进行综合评估。

Fabless 模式，综合终端客户/代理商销售预测情况，提前通知外发加工厂进行备货，关键原材料可自行对接供应商进行审核并议价。选择外发加工厂，综合考虑质量、价格、交货时间、环境和稳定性，除此之外还根据管理条件、社会性和环保工作进行综合评估。

## （2）销售模式

采用分销以及直供两种模式。业务/市场部门携手明确了客户群体，并针对性地开展了客户开拓及市场推广工作。对于重点客户，公司半导体业务单位直接提供技术支持或销售服务，同时，也充分利用公司自有的渠道资源进行代理销售，从而进一步提升了整体利润率。在公司分销渠道资源无法覆盖的地域及中小客户时，可以利用其他代理商资源为客户提供技术和物流服务。

## （三）报告期内主要业绩影响因素

报告期内，公司实现营业收入 534,637.40 万元，较上年同期增长 7.83%；归属于上市公司股东的净利润 6,027.50 万元，较上年同期增加 9.84%；扣非后归属于上市公司股东的净利润为 4,254.44 万元，较上年同期增长 67.60%。

具体情况说明如下：

### 1. 分销业务

受到宏观经济及市场竞争加剧的影响，产业链各参与主体毛利均被压缩，报告期内公司电子元器件分销业务实现营业收入 488,176.54 万元，较上年同期有所增加，毛利率较上年同期下降 0.37 个百分点。

2024 年全年，消费性电子产品在 AI 技术的推动下实现了需求的恢复性增长，智能手机市场在经历下滑后重新增长，AI 手机的渗透率显著提升。而汽车业务中，随着智能驾驶技术的继续发展，尤其是电动汽车和智能化领域，展现出了强劲的增长动力。

手机及汽车业务是公司目前分销业务中占比最大的两类，面临行业的变化及压力，此两大类业务的增长，确保了分销业务板块的整体增长。公司积极提升产业链服务能力，持续聚焦大客户战略，将现有的大客户做大做深做稳。同时，公司以市场需求为导向，构建上下游战略协同机制，通过规模化、多元化的资源整合策略，不断引入高毛利产品线，并积极开拓新客户群体，寻求变化市场中的持续经营与高质量稳定发展。

### 2. 芯片设计制造业务

公司全资子公司英唐微技术专注于光电转换和图像处理的模拟 IC 和数字 IC 产品的研发生产，在 MEMS 微振镜相关领域拥有丰富的研发经验，形成了多项专利技术，并拥有 6 英寸晶圆器件产线。英唐微技术员工合计 247 人，其中生产及技术人员合计占比近 70%。

在车载显示芯片产品方面，公司 2023 年内与美国新思（Synaptics）签订了合作协议，新思将应用于车载显示领域的 DDIC 及 TDDI（触控与显示驱动芯片）两款产品的特许经营权授权给公司，公司得以机会正式进入了车载显示领域。公司首款 DDIC 产品、首款 TDDI 产品分别于 2024 年 8 月、12 月实现批量交付。同时，DDIC 与 TDDI 的后续改进型版本也已步入研发快车道，旨在适应大屏化、多屏化、高清化的车载显示需求和 HUD（抬头显示）等新兴市场需求，强化产品竞争优势，部分改进型产品有望在 2025 年度内实现批量交付。

报告期内，公司芯片设计制造业务获得营业收入 43,542.25 万元人民币，占公司 2024 年度营业收入总规模的 8.14%，较上年同期增长 25.12%。

同时旨在更好地适应大屏化、多屏化以及高清化的车载显示需求，并满足 HUD（抬头显示）以及消费电子领域等市场的迫切需求，公司持续加大在显示驱动芯片领域的研发投入，车载 DDIC 与 TDDI 的后续改进型版本步入研发快车道，新款车载 DDIC 产品已经完成流片并通过客户验证，新款车载 TDDI 产品及消费电子领域的 DDIC 产品也即将完成研发并开启流片，上述新款产品有望在 2025 年度内实现批量交付。在此背景下，公司 2024 年研发投入 9,944.84 万元，较上年同期 3,884.92 万元增幅为 155.99%。

随着公司自研芯片产品的逐步增产上市，未来，其整体销售收入构成及综合毛利率预计将伴随芯片产品的陆续投产而迎来积极正向的调整。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	3,594,309,177.09	3,686,724,388.45	-2.51%	3,504,876,154.97
归属于上市公司股东的净资产	1,743,188,068.26	1,707,127,722.61	2.11%	1,903,624,030.08
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	5,346,374,019.51	4,958,213,756.29	7.83%	5,168,696,069.54
归属于上市公司股东的净利润	60,274,977.13	54,876,213.52	9.84%	57,489,824.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,544,370.00	25,384,035.15	67.60%	56,112,935.52
经营活动产生的现金流量净额	412,880,440.63	127,344,798.50	224.22%	199,987,526.97

基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%	0.05
加权平均净资产收益率	3.47%	2.70%	增加 0.77 个百分点	3.56%

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,257,355,736.11	1,292,291,552.29	1,467,080,201.85	1,329,646,529.26
归属于上市公司股东的净利润	18,515,323.11	17,273,371.59	10,488,750.74	13,997,531.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,456,440.74	16,878,615.44	10,491,439.81	-3,282,125.99
经营活动产生的现金流量净额	146,796,042.00	103,708,328.66	19,412,742.63	142,963,327.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	82,285	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,094	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
胡庆周	境内自然人	10.87%	123,429,292.00	92,571,969.00	质押 冻结	91,290,000.00 22,547,169.00			
深圳盈富汇智私募基金有限公司—盈富臻选 1 号私募证券投资基金	其他	1.80%	20,461,900.00	0.00	不适用	0.00			
珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 112 号私募证券投资基金	其他	1.16%	13,189,800.00	0.00	不适用	0.00			
向上	境内自然人	1.15%	13,010,000.00	0.00	不适用	0.00			
张跃军	境内自然人	0.93%	10,559,100.00	0.00	不适用	0.00			
吕强	境内自然人	0.76%	8,642,200.00	0.00	不适用	0.00			
刘胜刚	境内自然人	0.61%	6,888,000.00	0.00	不适用	0.00			
余军	境内自然人	0.46%	5,216,400.00	0.00	不适用	0.00			
邵学广	境内自然人	0.45%	5,118,854.00	0.00	不适用	0.00			
王桂萍	境内自然人	0.42%	4,781,968.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动关系。								

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

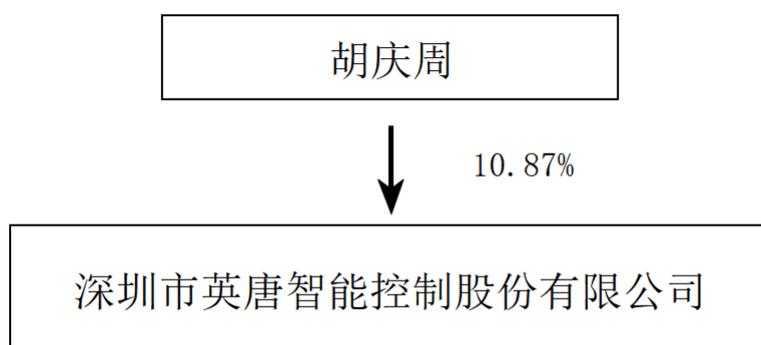
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

(1) 股份回购

2024 年 8 月 28 日，公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，公司拟使用自有资金不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），以集中竞价方式回购公司部分社会公众股股份，回购的股份拟全部予以注销并相应减少注册资本。

2024 年 11 月 1 日，公司实施了首次回购股份，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购股份数量为 257.76 万股，占公司目前总股本的 0.23%，最高成交价为 7.10 元/股，最低成交价为 6.81 元/股，支付的总金额为人民币 17,988,471.84 元（含交易费用），本次回购事项已实施完毕，本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

2024 年 11 月 7 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次已回购股份 2,577,600 股已完成注销。本次回购注销股份的数量、完成日期、注销期限均符合有关法律法规的规定。

## (2) 收购芯片设计公司

为深入推进公司在半导体行业的发展，报告期内，公司与 BVI 公司 Wealth Shining International Limited 签署股权转让协议，公司以 1,000 万美元收购其全资控股的 BVI 公司 Concord Technology Venture Limited（以下简称“Concord”）100%股权及 Concord 的全资子公司大和科技株式会社（现已更名为“YITOA テクノロジー株式会社”）。

YITOA テクノロジー株式会社已汇聚研发人员近 50 人，专注于车载显示领域，未来可在车载显示领域为公司持续贡献力量，推动技术创新，提升产品竞争力，为公司创造价值。

## (3) 芯片项目新进展

### 1. MEMS 微振镜

“深圳市英唐智能控制股份有限公司 MEMS 微振镜研发及产业化项目”拟投入募集资金 2.17 亿元，截至 2024 年年末，累计已投入 14,090.76 万元，投资进度 64.8%。目前  $\phi 4\text{mm}$  规格的 MEMS 微振镜即将迈入生产阶段。

### 2. 车载显示芯片

公司车载显示芯片 DDIC 和 TDDI 已于 2024 年 8 月、12 月先后实现批量生产，标志着公司在车载显示芯片领域实现了从研发到量产的跨越性突破。

公司先后完成了部分国内屏幕厂商、海外液晶显示屏厂商的批量订单交付，公司将充分利用分销业务的庞大客户资源优势，将自研芯片深度融入市场，积极对接汽车厂商的新项目需求，在现有订单稳步执行的基础上，致力于不断扩大市场份额，积极争取更多新项目的定点合作，以期实现营业收入和利润的双重增长。